

表面実装基板推奨寸法
RECOMMENDED P.C.BOARD DIM.'S FOR SMT

注記
NOTES.

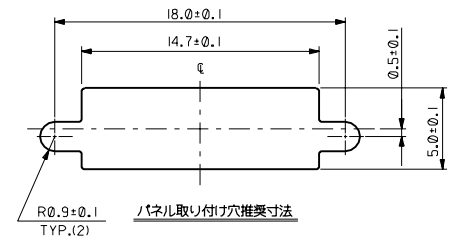
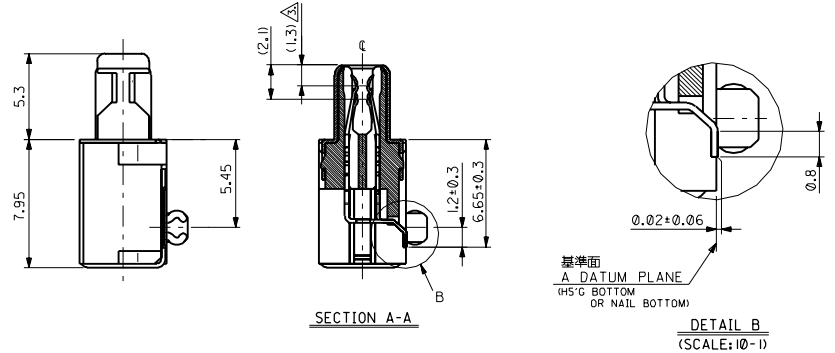
1. 材料

MATERIAL
ハウジング : ガラス入りLCP UL 94V-0材 色 : 黒
HOUSING: G.F.LCP UL94V-0 COLOR:BLACK
ターミナル : リン青銅
TERMINAL: PHOSHOR BRONZE

2. メッキ仕様
PLATING

接点部 : 金メッキ 0.5µm MIN.
CONTACT AREA: GOLD
半田付け部 : 半田メッキ 1.0µm MIN.
SOLDER AREA: TIN-LEAD
下地メッキ : ニッケル下地 2.0µm MIN.
UNDER PLATING AREA: NICKEL
シールド部 : ニッケルメッキ 2.0µm MIN.
SHIEDED AREA : NICKEL

- △ 両端各2端子。(計4端子)
2 TERMINAL AT BOTH ENDS (TOTAL:4 TERMINALS)
- 4. 推奨基板厚 t:1.0±0.1
RECOMMENDED P.C.B. THICKNESS t:1.0±0.1
- △ 位置決めベア穴
POSITION HOLE (PEG HOLE)
- △ コネクタは、必ず半田付け前にねじ止めすること。
TO BE SCREW LOCK CONNECTOR BEFORE SOLDERING.



角度 ANGLE	±3°	材料 MATERIAL	—	MOLEX-JAPAN CO.,LTD. 日本モレックス株式会社
30以上 OVER	±0.2	体上付 FINISH	—	
10以上 30未満 UNDER	±0.25	適用電線規格 WIRE RANGE	—	REVISE ONLY ON CAD SYSTEM
10 UNDER	±0.2	被覆径 INS. RANGE	—	TITLE 名称
公差 GENERAL TOLERANCES	0	新規作成 PROPOSED	SJ YI YP/07/08	1.0 mm PITCH
記号 ITR	0	変更内容 REVISION RECORD	DR. 品名 尺原 SCALE 5-1	I/O REC HS'G ASS'Y
		承認者 APP'D BY	尺原	DWG. NO. SD-52629-1051
		検査者 CHK'D BY		REV 0